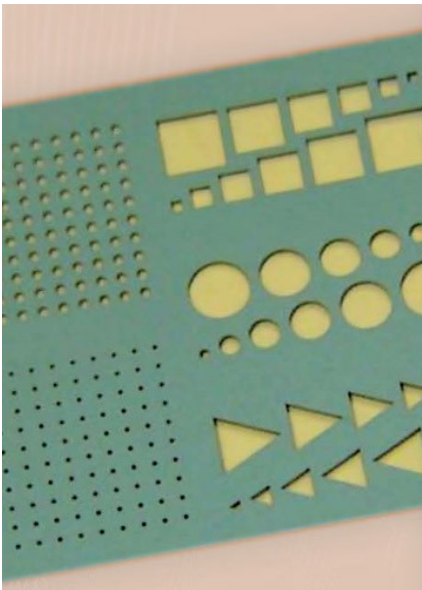


Cięcie Green Tape frezarko-wiertarką firmy LPKF

Czy wiesz, że frezarko-wiertarki firmy LPKF są idealne także do cięcia Green Tape? Green Tape jest nieutwardzoną termicznie ceramiką, często używaną jako podłoże w elektronice. Proces jest bardzo prosty. Dane z programu CAD w formacie Gerber lub DXF należy poddać obróbce w CircuitCAM – w ten sam sposób jak w przypadku PCB.



Przed zapisaniem dokumentu należy pamiętać o obliczeniu wszystkich ścieżek frezowania i cięcia. Drobną wskazówką co do cięcia: upewnij się, że narzędzie frezujące typu "long two-flute cutters" jest używane do wycinania wewnętrznych i zewnętrznych konturów. Po obróbce i zapisaniu danych należy je wyeksportować do formatu LMD w standardowy sposób.

Otwierając programu BoardMaster, importujemy plik i pozycjonujemy projekt na materiale. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy ustawienia grubości materiału są poprawne (Configuration >> Material >> Size). Po wybraniu odpowiedniej fazy pracy, klikamy na "ALL+" i "Start".

Zapraszamy do składania [zapytań](#) - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!



SE Spezial-Electronic Sp. z o.o.
ul. Stępińska 22/30 lok. 209 00-739 Warszawa
tel. 022 840 91 10 fax. 022 841 20 10
www.spezial.pl